

# 令和4年度 京都実装技術研究会 第3回例会

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、本年度第3回例会として、下記のとおりご講演いただきます。皆様のご参加をお待ちしております。

◇ 開催日時 令和5年1月20日（金） 13:30 ~ 15:30

◇ 開催方式 会場参加/Web 併用（講師は会場でご講演いただきます）

◇ 会場 京都府産業支援センター 5階 研修室  
（京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内）

◇ 内容

「鉛フリーはんだの高品質実装工程での品質管理手法の適用例と信頼性試験の一例について」  
ANDO実装研究所 所長 当田貞行氏

電子部品の品質の確保には、数多くの品質管理手法及び信頼性試験が実施されています。中でも車載電子部品は、温度が100度以上になるエンジンルーム内で使用されることもあり、高度な品質管理が要求されます。2000年代以降は鉛フリーはんだの使用が進み、鉛フリーはんだを使用した電子部品の信頼性試験も求められるようになりました。

本講演では冷熱衝撃試験を用いたはんだ接合の評価等、電子部品の開発段階・量産段階でこれまで携わってきた、品質管理手法や信頼性評価試験の例について紹介いただきます。

◇ 定員 Web：応募状況により調整 会場：40名程度

◇ 参加費 会員：無料 非会員：10,000円  
（研究会入会希望の方は事務局までお問合せください。  
年会費20,000円/社 令和4年度は無料）

◇ 申込締切 令和5年1月18日（水）まで

◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係  
（京都実装技術研究会事務局）  
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497  
E-mail denki@kptc.jp

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係 宛  
（denki@kptc.jp 又は FAX 075-315-9497）

## 令和4年度 京都実装技術研究会 第3回例会申込書

会社名		
所在地		
連絡担当者	所属・役職	
	氏名	
	E-mail	
	電話番号	
参加者	所属・役職	氏名
参加方法	<input type="checkbox"/> 会場参加	<input type="checkbox"/> Web参加

※申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

### 受講に当たっての注意点

- Web参加については必ずWebカメラをONにしてご参加をお願いします。
- Web参加は、1事業所1接続でお願いします。複数名で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。
- 録画、録音等の配信データの記録、保存は一切禁止です。
- 会場には消毒液を設置し、会場の窓や扉の開放等による換気、他の受講者との間隔をあける等の対策をいたします。ご来所の際は、マスクの着用と丁寧な手洗い・手指消毒をお願いします。また、発熱等の症状がある方はご来場をお控えください。